

正本

發文方式：紙本郵寄

檔號：

保存年限：

桃園市政府建築管理處 函

330026

桃園市桃園區縣府路232號

地址：330206桃園市桃園區縣府路1號

承辦人：專員 林國棟

電話：03-3322101#6115

電子信箱：10048993@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市建築師公會

發文日期：中華民國114年10月3日

發文字號：桃建企字第字第1140093348號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：函轉社團法人台灣智慧建築協會辦理「2026國際永續智慧建築暨智慧建材展」相關資訊，請貴單位轉知所屬及會員參與，請查照。

說明：

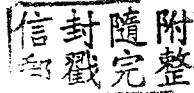
- 一、本次展會將邀集國際指標企業及產官學界代表參加，誠摯邀請貴單位參與，拓展國際交流及合作契機。
- 二、詳展會介紹及報名連結、聯絡窗口如附件，請貴單位轉知所屬及會員踴躍報名參加。

正本：桃園市政府智慧城鄉發展委員會、桃園市不動產建築開發商業同業公會、桃園市建築師公會

副本：

處長莊敬權

本案依分層負責規定授權業務主管決行



社團法人台灣智慧建築協會
Taiwan Intelligent Building Association

社團法人台灣智慧建築協會 函

立案證號：內政部台內社字第 0990058501 號函核准立案
協會地址：台北市信義區基隆路二段 23 號 12 樓之 1
聯絡人：陳怡君
聯絡電話：(02)2752-8072#106
電子郵件：eichen@tiba.org.tw

受文者：桃園市政府

發文日期：中華民國 114 年 9 月 17 日

發文字號：台智建字第 1140049 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：「2026_BuildforNextGen」展覽介紹

主旨：敬邀貴單位參加「2026 國際永續智慧建築暨智慧建材展」，請查照。

說明：

- 一、為推動國際智慧永續建築與智慧建材發展，由本會主辦「2026 國際永續智慧建築暨智慧建材展」(2026 Build for NextGen)，訂於 2026 年 9 月 1 日至 4 日假台北世貿展覽館一館舉辦。
- 二、2026 國際永續智慧建築暨智慧建材展以「智慧建築-創新驅動未來」為主題，集結國內外物聯網、能源科技、智慧建材等領域方案，展示最新應用與發展趨勢，規劃為期四天的展會及專業論壇。
- 三、本次展會將邀集國際指標性企業、政府單位與產業公、學、協會、醫療院所以及大專院校參與，主題包含：智慧商辦、智慧醫療、智慧校園、智慧住宅、智慧建材、智慧機電與工程、智慧建築及 AI 解決方案，並舉辦國際智慧建築高峰會、國際論壇與媒合交流活動等，期能促進跨國產業合作，展現智慧建築與科技生活的創新成果，並提升臺灣在國際舞台的能見度。
- 四、謹此誠摯邀請貴單位參與，共同推動智慧建築與低碳永續發展，並盼能藉由此次盛會，拓展國際交流及合作契機。

訂

線



社團法人台灣智慧建築協會
Taiwan Intelligent Building Association

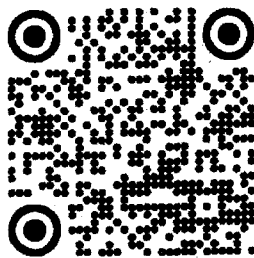
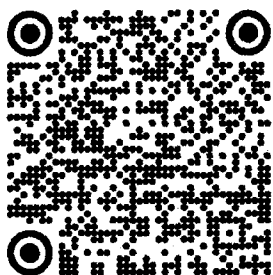
五、「2026 國際智慧永續建築暨智慧建材展」展會介紹如附件。

(一) 時間：2026 年 9 月 1 日至 4 日(週二至週五)

(二) 地點：台北世貿展覽館一館 A 區

(三) 活動資訊

報名連結



(四) 聯絡窗口：陳怡君副理，電話：02-27528072#106，E-mail:

nextgen@tiba.org.tw

正 本：台北市政府、新北市政府、基隆市政府、桃園市政府、新竹市政府、台中市政府、嘉義市政府、台南市政府、高雄市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府、中華民國人工智慧學會、中華民國不動產建築開發商業同業公會全國聯合會、中華民國台灣資訊科技發展協會、中華民國尖端材料科技協會、中華民國自動化科技學會、中華民國資訊軟體協會、中華民國資訊應用發展協會、中華民國資訊聯盟、中華民國電器商業同業公會全國聯合會、中華民國電機技師公會、中華亞太智慧物聯發展協會、中華物聯網與人工智慧研究學會、中華資訊與科技教育學會、台中市直轄市電器商業同業公會、台北市不動產開發商業同業公會、台北市電器商業同業公會、台南市直轄市電器商業同業公會、台灣日本開放式物聯網協會、台灣物聯網協會、台灣物聯網產業技術協會、台灣建築資訊模型協會、台灣建築學會、台灣區水泥製品工業同業公會、台灣區冷凍空調工程工業同業公會、台灣區電信工程工業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區模具工業同業公會、台灣智慧人居產業促進會、台灣智慧生活空間發展協會、台灣智慧生活科技學會、台灣智慧安防工業同業公會、台灣智慧自動化與機器人協會、台灣智慧技術協會、台灣智慧物聯資訊發展協會、台灣智慧建築物業管理協會、台灣智慧解決方案協會、台灣雲端物聯網產業協會、台灣綠色智慧科技協會、台灣綠建材產業發展協會、亞洲物聯網聯盟、社團法人中華民國建築經營協會、社團法人中華建築資訊模型標準協會、社團法人台灣病態建築診斷協會、社團法人台灣智慧城市發展協會、社團法人台灣智慧淨零建築產業聯盟、社團法人台灣資通產業標準協會、社團法人台灣輔具暨長期照護產業



社團法人台灣智慧建築協會
Taiwan Intelligent Building Association

發展協會、社團法人全通智慧系統策進會、社團法人建築安全履歷協會、桃園市電器商業同業公會、高雄市電器商業同業公會、智慧產業電腦物聯網協會、新北市電器商業同業公會、資通訊產業聯盟、財團法人工業技術研究院綠能與環境研究所、財團法人資訊工業策進會軟體技術研究院、財團法人臺灣營建研究院、財團法人工業技術研究院材料與化工研究所、社團法人臺北市都市更新學會

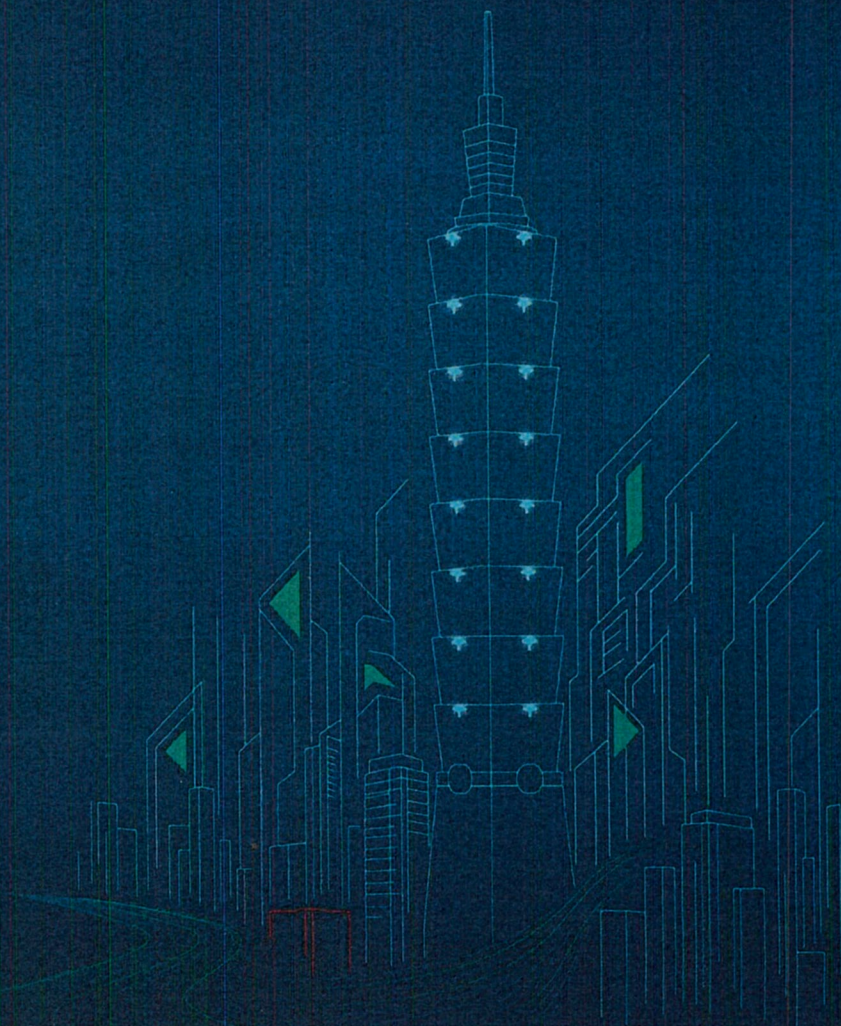
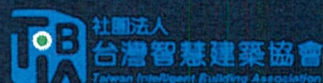
副 本：社團法人台灣智慧建築協會

理事長 溫琇玲

Build for NEXTGEN

國際永續智慧建築暨智慧建材展
「智慧、永續、新世代」

TWTC 台北世貿
2026/09/01(二)-04(五)



Build for NextGen

為下一代建築而生，連結 智慧 與 永續

“由TIBA/APIGBA 領銜策辦，
集結亞太智慧建築及科技生態系資源，
打造一個以「智慧、永續、新世代」
為核心的國際級智慧建築展會平台”

Smart
智慧

Sustainable
永續

NexGen
新世代

- ✓ 在全球氣候變遷、人口集中與數位科技驅動下，智慧建築正成為城市發展的核心。透過 **設計優化、能源智慧化、資源高效應用**，全面提升居住與生活品質，推動建築邁向**數位化、智慧化、低碳永續**。
- ✓ 本次展覽以「**智慧建築 – 創新驅動未來**」為主題，集結國內外物聯網、能源科技、智慧建材等領域解決方案，展示最新應用與發展趨勢。
- ✓ 除了多元主題展區，亦舉辦 **國際高峰論壇、沙龍對談、案例分享、B2B媒合**，促進跨域交流與產業鏈整合，加速智慧建築落地，打造 **安全 × 高效 × 永續 × 以人為本** 的理想空間。



擴強品牌國際能見度

International Visibility Enhancement

在國際舞台展示技術實力



對接國內外市場買家

Overseas Business Development

打造跨國合作與商機媒合



連結國際認證標準

Global Certification Connection

與APIGBA認證接軌互認



打造智慧建築生態系

Smart Building Ecosystems Establishment

整合業主、廠商、顧問、政策

TIBA AWARD – 最強智慧建築案例卡司



1. 設計類獎(Design Award)
2. 營運類獎(Performance Award)
3. 既有建築改造類獎(Renovation Award)
4. 系統產品類獎(System Award)



APIGBA (亞太地區智慧綠建築聯盟) 不僅是學術與技術交流平台, 更是參展商開拓國際市場的最佳夥伴

- ✓ **國際曝光:** 來自亞太超過 10 個國家的協會組織支持
- ✓ **政策背書:** 獲得各國政府與標準機構的信任
- ✓ **跨國合作:** 直接鏈結各國建築師協會與開發商
- ✓ **實際業務:** 專屬媒合會與參訪團, 創造真實商機



內政部優良智慧建築獎 – 國家領銜主導

<https://apigba.org/>

- ✓ 由內政部主辦，推廣智慧建築，提升建築數位化與智慧化水準。
- ✓ 歷屆頒獎典禮均由部會首長與官員蒞臨，顯示政策高度重視。
- ✓ 展會期間，中央與地方政府首長、產業領袖將參訪展區。
- ✓ 為參展企業創造高層曝光 + 政策鏈結 + 實質合作機會。



台灣智慧建材 - 全台最新解決方案展示



智慧建材標章是台灣自有的智慧建材認證制度，代表產品符合國際與在地規範，為建築師、開發商提供「**可信賴的產品清單**」，降低採購風險

截至 2025 年：

- ✓ 30+家廠商，100+產品已獲標章
- ✓ 應用於50+ 智慧建築專案
- ✓ 為亞洲首個與國際認證互認的智慧建材標準



國際智慧建築高峰會 – 重磅精彩內容



展區業主參訪團專屬導覽 - 多國商機對接

國際建築師團體、開發商專屬導覽行程 | 專屬解說，快速掌握解決方案 | 促進國際間的技术合作與投資交流



業主需求規劃媒合 – 客製化需求對接

1. 會前需求蒐集 (問卷 + 線上平台) -----> ✓ 需求出發
2. 精準配對 (依產業類別 / ESG需求 / 技術領域) -----> ✓ 精準媒合
3. 展中一對一會談 (專屬媒合區) -----> ✓ 創造合作



展覽簡介

Date **時間** : 2026年9月1日~9月4日
1-4 Sep. 2026

Location **地點** : 台北世貿一館A區
Taipei World Trade Center (Area A)

Scale **規模** : 378 Booths

Theme **主題** : 智慧商辦 Smart Office building
智慧醫療 Smart Healthcare
智慧校園 Smart Campus
智慧住宅 Smart Residential
智慧建材 Intelligent Building Materials
智慧機電與工程 Smart Engineering
智慧建築及AI解決方案
Smart Building & AI Solutions



參展費 Participation Fees

攤位
Vender
價格 / 每格
Price / Per one

淨地
Raw Space

\$ 80,000

早鳥價 Early Bird Price (~2025/12/31)

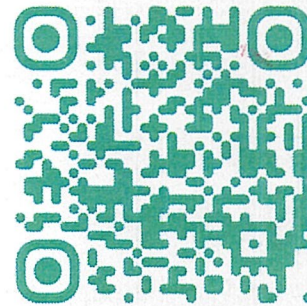
淨地
Raw Space

\$ 77,000

- ◆ 單位：新台幣(元) Unit：NTD
- ◆ 使用範圍：300cm*300cm/格
- ◆ 一次下訂15格以上，享**95折**優惠
- ◆ 已取得智慧建材標章者，
可折**5,000/格**，至多**3格**
- ◆ 早鳥價須於**2025/12/31**前完成總價
20%的訂金匯款，並於**2026/03/31**前
完成剩餘款項匯款
- ◆ 本展會僅提供淨地，主辦單位另推薦廠
商提供標準攤位服務
- ◆ 以上價格皆為未稅價

Build for NEXTGEN

國際永續智慧建築暨智慧建材展



掃描下載報名表

聯絡專線: 02 2752 8072

Email: nextgen@tiba.org.tw

TWTC 台北世貿

2026/09/01(二)-04(五)

